

证券代码： 873521

证券简称：鼎尚电子

主办券商：开源证券

江苏鼎尚电子材料股份有限公司

关于向银行贷款暨资产抵押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关于预计公司 2023 年申请借款额度情况

为了保证公司 2023 年资金流动性，增强资金保障能力，满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2023 年拟对外申请借款总额度不超过人民币 1,000 万元。在办理授信过程中，公司拟以名下的不动产权提供抵押担保。申请银行贷款的具体授信额度、时间及期限等情况以公司与银行正式签署的授信协议、贷款合同等生效法律文件为准。资金出借方包括并不限于银行、其他金融机构。

如有必要，公司实际控制人葛建平、张秋红将自愿无偿为公司借款提供抵押担保。

葛建平为公司法定代表人、董事长，公司授权葛建平全权代表公司签署上述借款额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司董事会不再逐笔形成董事会决议。

二、审议与表决情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二次会议，以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，审议通过了《关于公司 2023 年预计借款暨资产抵押的议案》。根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议。

三、公司申请贷款的必要性及对公司的影响

公司本次申请贷款是为了保证公司 2023 年资金流动性，增强资金保障能力，有利于公司日常性经营及业务发展，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

《江苏鼎尚电子材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

江苏鼎尚电子材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日